



# 京鼎精密科技股份有限公司

## 2023第三季法人說明會

2023/12/13

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

邱耀銓

總經理

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

陳鎮福

特 助

黃俊凱

協 理



# 公司簡介



成立時間：2001/4/26

資本額：9.72億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- 2001 公司設立
- 2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產
- 2015 TWSE 掛牌上市
- 連續七年獲得世界第一大半導體設備製造商肯定
- 2016~2022 連續六年獲頒世界第一大半導體設備製造商的「最佳供應商獎」
- 2020 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎
- 2022 榮獲HR Asia所頒發的「2022亞洲企業最佳雇主獎」
- 2022 榮獲商業週刊評比「碳競爭力100強」
- 2023 京鼎首本永續報告書榮獲2023 TCSA永續報告書銅獎

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



美國矽谷廠



加州

德州

南京  
江蘇  
上海  
竹南

美國矽谷辦公室



上海松江廠



江蘇昆山廠

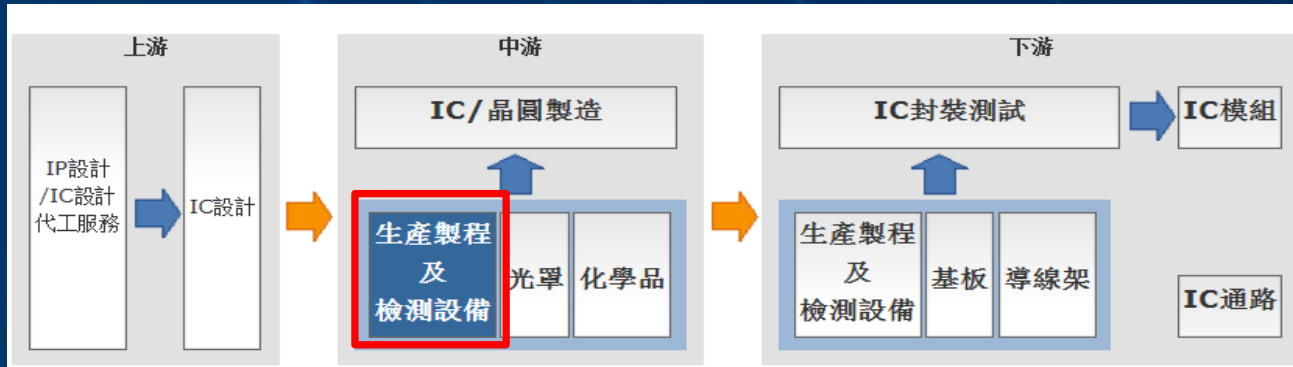


- ：營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠
- ：新產品導入與少量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務據點-加州/德州/南京

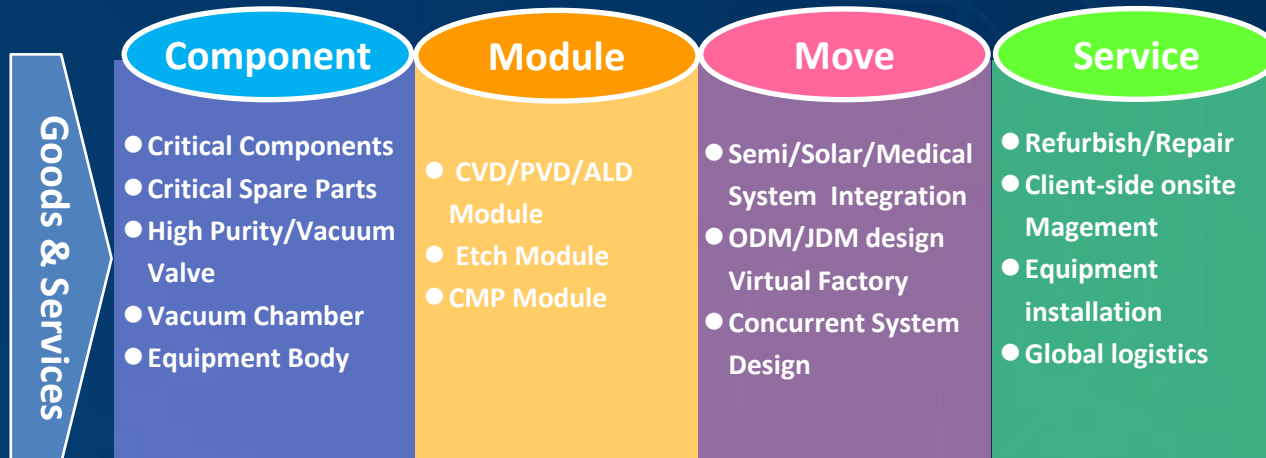
# 市場定位



## 1. 半導體前段製程設備



## 垂直整合製造服務營運模式



## 2. 半導體自動化設備



提供整合性解決方案

客製化

模組化

智能化

# 產業/產品佈局

- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關  
設備生命週期  
製造服務

半導體廠自動化  
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
  - 先進製程微污染防治方案
  - 晶圓AOI檢測設備
  - 氮氣倉儲系統
  - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件  
再生循環經濟

醫療設備開發及  
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備



# 財務報告

# 綜合損益表



單位：新台幣百萬元	3Q23		2Q23		QoQ%	3Q22		YoY%	YT3Q23		YT3Q22		YoY%
營業收入淨額	2,977	100.0%	3,292	100.0%	-9.6%	4,055	100.0%	-26.6%	9,671	100.0%	10,662	100.0%	-9.3%
營業毛利	756	25.4%	841	25.5%	-0.1 pts	1,228	30.3%	-4.9 pts	2,489	25.7%	3,089	29.0%	-3.3 pts
營業費用	(346)	(11.6%)	(350)	(10.6%)		(400)	(9.9%)		(1,038)	(10.7%)	(1,079)	(10.1%)	
營業利益	410	13.8%	491	14.9%	-1.1 pts	828	20.4%	-6.6 pts	1,451	15.0%	2,010	18.9%	-3.9 pts
營業外損益	187	6.3%	228	6.9%		155	3.8%		407	4.2%	360	3.3%	
稅前淨利	597	20.1%	719	21.8%	-1.7 pts	983	24.2%	-4.1 pts	1,858	19.2%	2,370	22.2%	-3.0 pts
本期淨利	473	15.9%	609	18.5%	-2.6 pts	791	19.5%	-3.6 pts	1,486	15.4%	1,927	18.1%	-2.7 pts
歸屬予：													
母公司股東	473		609		-22.3%	787		-39.9%	1,486		1,903		-21.9%
基本每股盈餘(元)	4.87		6.27		(1.40)	8.14		(3.27)	15.29		20.41		(5.12)
加權平均流通在外股數(百萬股)	97.18		97.16			96.71			97.15		93.21		



# 資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	3Q23		2Q23		3Q22	
現金及流動金融資產	9,305	51%	10,408	53%	8,769	46%
應收帳款	862	5%	919	5%	1,386	7%
存貨	2,791	15%	2,904	15%	4,059	21%
長期投資	568	3%	569	3%	548	3%
不動產、廠房及設備	3,787	21%	3,723	19%	3,258	17%
<b>資產總計</b>	<b>18,323</b>	<b>100%</b>	<b>19,514</b>	<b>100%</b>	<b>19,132</b>	<b>100%</b>
應付帳款	894	5%	956	5%	1,718	9%
應付公司債	1,864	10%	1,859	10%	1,844	10%
流動負債	4,918	27%	6,668	34%	4,758	25%
<b>負債總計</b>	<b>7,223</b>	<b>39%</b>	<b>9,042</b>	<b>46%</b>	<b>8,690</b>	<b>45%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>11,100</b>	<b>61%</b>	<b>10,472</b>	<b>54%</b>	<b>10,442</b>	<b>55%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現天數	27		26		40	
平均銷貨天數	129		126		127	
平均付現天數	44		44		68	
淨營運現金週期天數	112		108		99	
流動比率(倍)	2.67		2.16		3.05	

# 現金流量表(update)



單位：新台幣百萬元	YT3Q23	YT3Q22
期初現金	8,544	5,068
營運活動之現金(流出)流入	1,507	1,611
資本支出	(469)	(1,691)
現金股利	(1,340)	(840)
定期存款	(2,990)	1,382
現金增資	-	1,706
銀行借款淨變動	(277)	1,472
投資與其他	72	(118)
期末現金	5,047	8,590
自由現金流量*	1,038	(80)

\*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# 營運與展望



# 營收趨勢

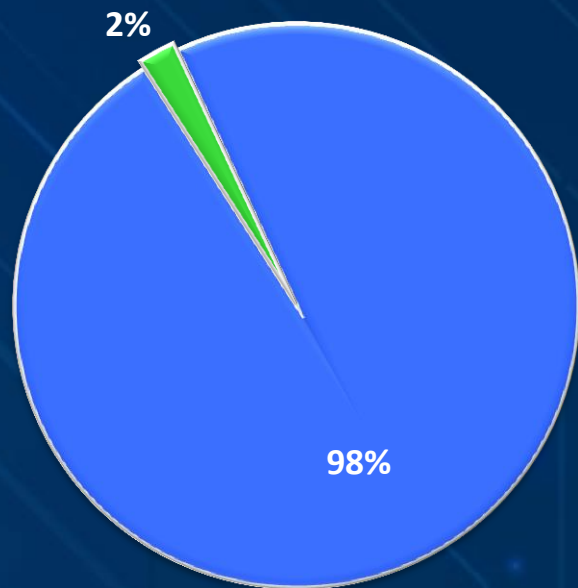


- Q3營收**29.77億** YoY **-26.6%** QoQ **-9.6%**
- 揮別Q3營運谷底，Q4將溫和季增



註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

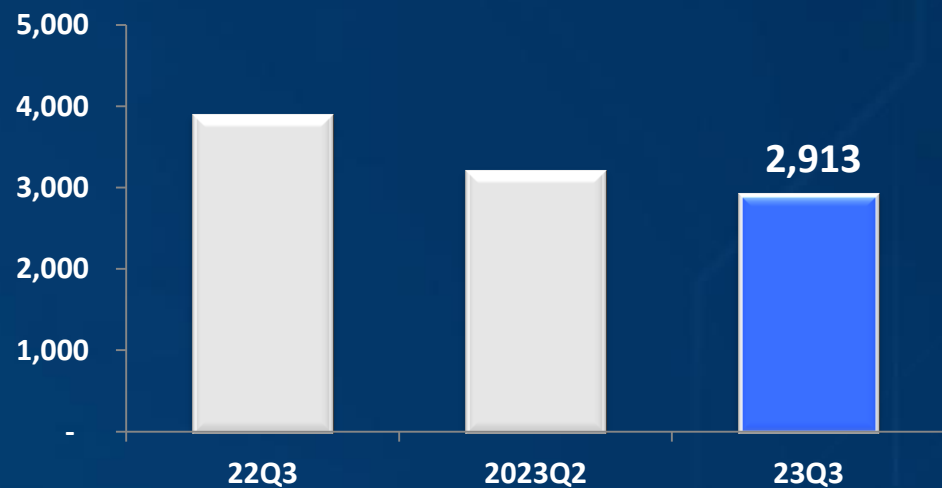
# 2023年第三季銷售分析-業務別



製造服務  
自主開發

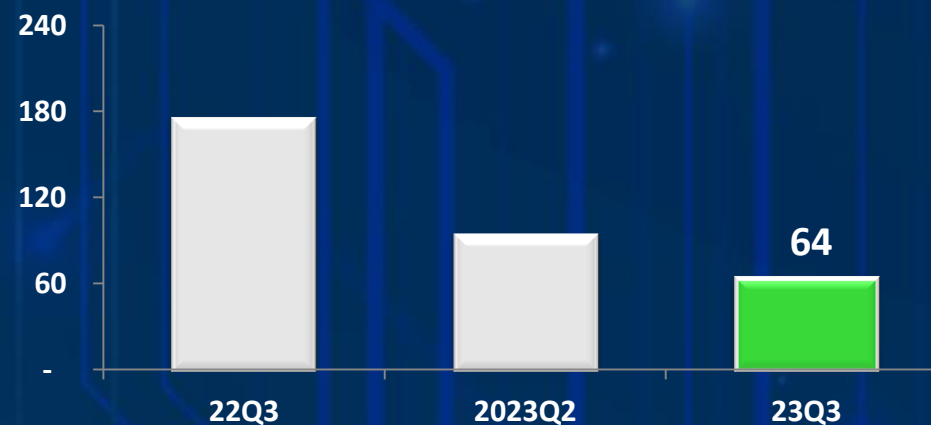
製造服務  
-8.9% QoQ  
-24.9% YoY

單位：台幣百萬



自主開發  
-32.5% QoQ  
-63.7% YoY

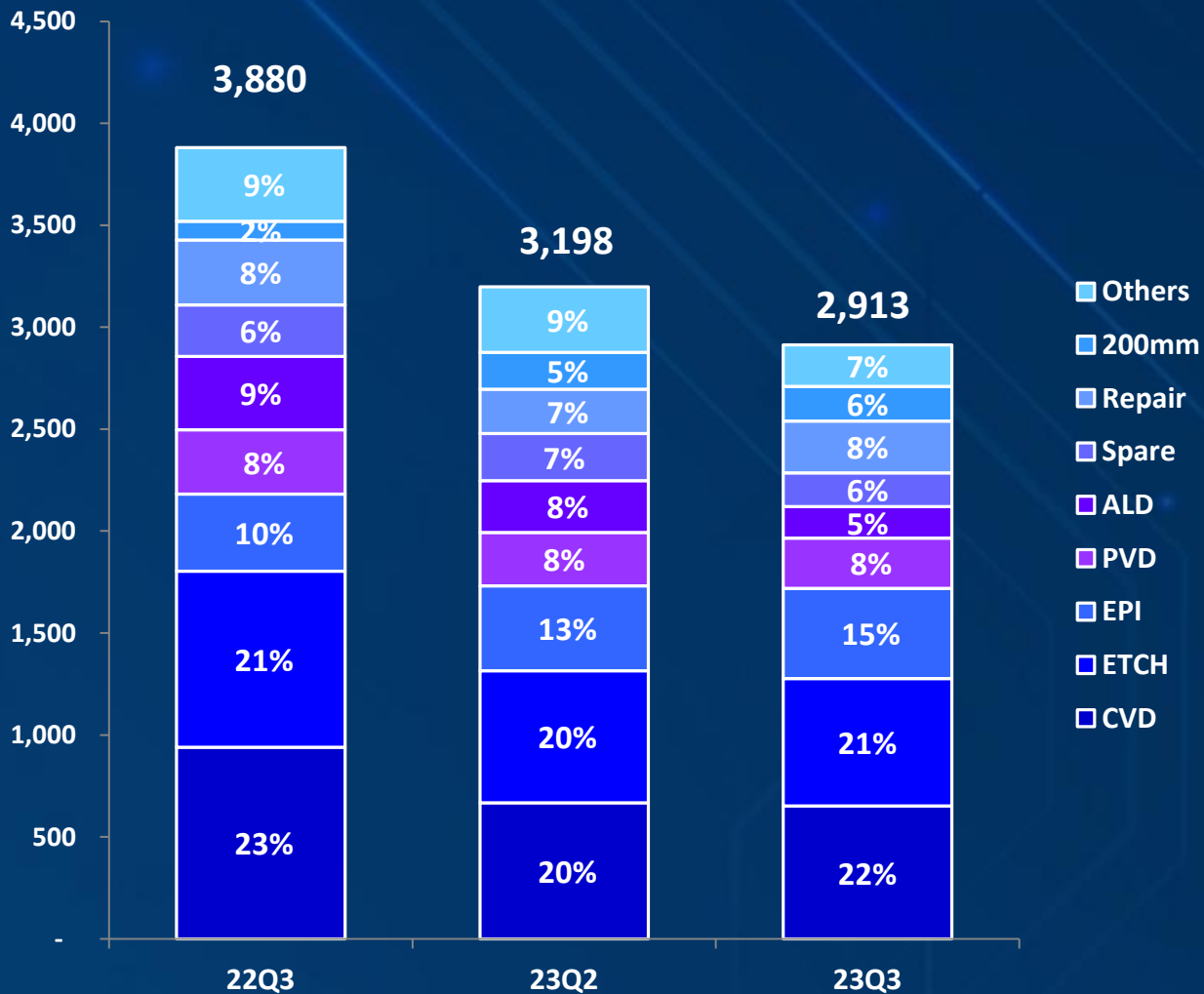
單位：台幣百萬



# 製造服務銷售分析-產品別

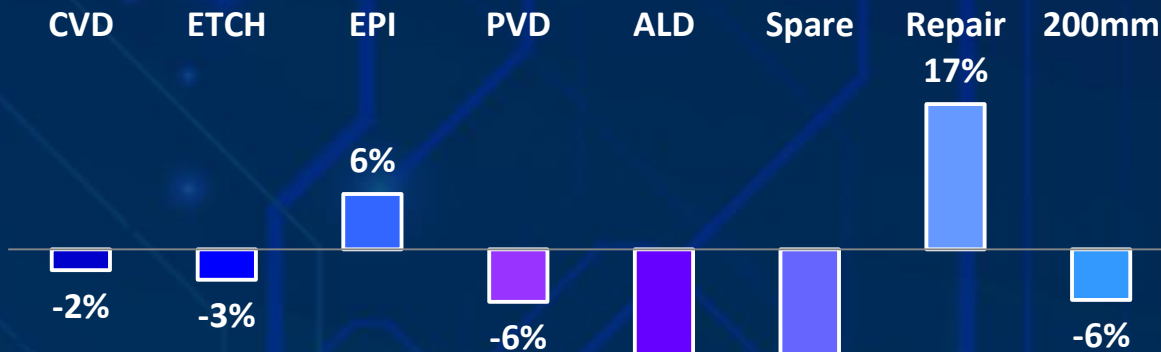


單位：台幣百萬

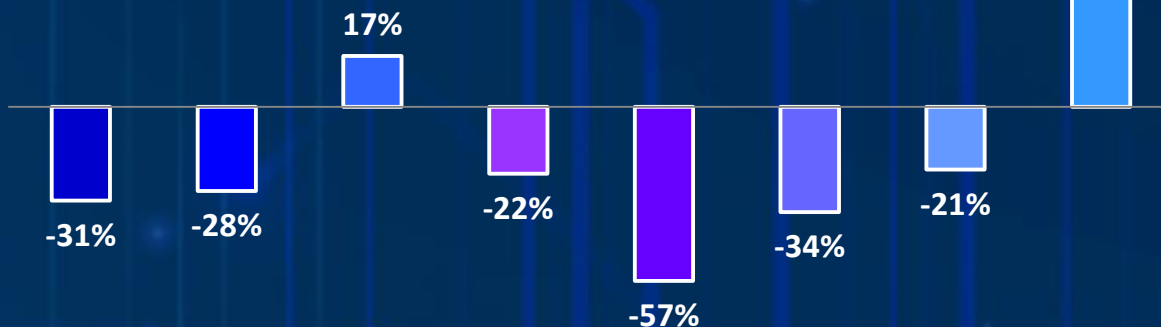


- Others
- 200mm
- Repair
- Spare
- ALD
- PVD
- EPI
- ETCH
- CVD

## 季變化



## 年變化





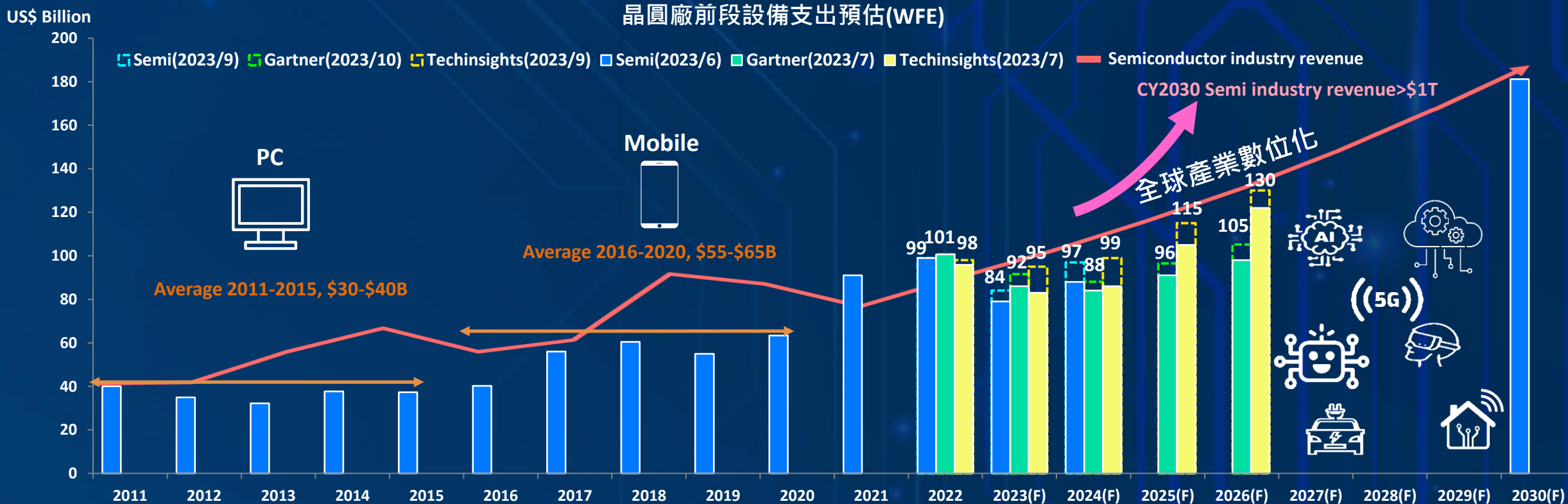
# 2023年第四季展望



# 產業趨勢



- 因美日荷先進設備出口管制，大陸擴大成熟製程設備採購，三家調研機構將2023年半導體設備支出預測從-13%~-20%上調至-5%~-13%，衰退幅度逐步縮小
- 庫存調整接近尾聲、記憶體市場供需趨於平衡以及AI/HPC/ICAPS(物聯網、通訊、汽車、電源、感測器等相關應用擴大帶動資本支出需求成長，2024半導體設備市場可望緩步回升，2025年全面復甦
- 新興科技領域應用帶動半導體含量上升、半導體製程日趨複雜、各國自主供應鏈及晶圓廠持續戰略性投資，推升半導體設備產業趨勢向上



# 近期重要事件摘要

- 京鼎發行首本永續報告書 榮獲2023 TCSA永續報告書銅獎
- 因地緣政治不確定性，董事會暫緩111年7月28日通過京鼎租地委建廠房案及大陸部份產能擴充計畫，同時為配合客戶需求，董事會決議投資1.2億美金赴泰國春武里府設廠，建立半導體前段製程設備關鍵模組、零部件及備品耗材製造生產基地，預計在2025H1投產，迎接半導體設備市場需求



# 總結

- 2023前三季營運表現符合產業水準
  - 前三季營收/EPS皆為同期次高
  - 揮別Q3營運谷底，Q4溫和回升
- 積極拓展新客戶，建立長期合作的戰略夥伴關係
- 布局多元生產，降低地緣政治風險，維持企業經營競爭力
- 展望2024，在新產品、新客戶及各國半導體獎勵政策效應加持下，成長將優於產業平均

# Q&A

The background of the slide is a complex, glowing blue circuit board. The circuit traces are illuminated with bright blue light, creating a sense of depth and technology. In the center of the board, there is a prominent square area that glows more intensely than the surrounding traces. The overall aesthetic is clean, modern, and high-tech.





# Thank you